

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

概 要

本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的概覽。由於這僅為概要，故並不包含可能對閣下而言屬重要的所有資料。閣下在決定投資[編纂]前務請閱讀整份文件。任何[編纂]均涉及風險。有關投資[編纂]的部分特定風險載於本文件「風險因素」一節。閣下在決定投資[編纂]前務請仔細閱讀該節。

概覽

集團總覽

我們是中國領先的智能控制解決方案提供商，專注於集成電路芯片的設計和交付，並以微控制器（「MCU」）作為我們產品的核心。憑藉專業能力並專注於實用技術進步，我們為廣泛應用場景提供高效能、低功耗且具成本效益的智能控制解決方案。根據弗若斯特沙利文的研究資料，我們是國內最早自主研發設計MCU的企業之一。我們的先發優勢與持續創新使我們始終保持行業領先地位。以2024年出貨量計，我們為中國排名第一的MCU企業，而以收益計則排名第三。

我們以MCU設計及開發能力為核心，旗下產品進一步延伸至各類系統級芯片（「SoC」）、專用集成電路（「ASIC」）等，為客戶提供智能控制所需的芯片及底層算法一站式整體解決方案，賦能消費電子、智能家電、工業控制及汽車電子等多元應用場景。於往績期間，我們的收益主要來自MCU、SoC及ASIC解決方案的提供，以及其他相關產品的銷售。

我們深耕多領域應用場景，在泛消費與高端賽道均形成核心競爭力。在泛消費領域，我們的MCU芯片產品在中國消費電子及智能家電領域佔據市場領先地位，根據弗若斯特沙利文的研究數據，以2024年收益計，我們在中國智能家電領域MCU芯片市場排名第一、消費電子領域MCU芯片市場排名第二；在泛消費領域基礎上，我們已成功突破MCU芯片高端化應用壁壘，順利切入工業控制與汽車電子兩大高增長關鍵賽道。

截至2025年12月31日，我們服務了合計超過1000名客戶，包括業界領先的企業、知名消費品牌以及著名的汽車製造商，為未來的成長與市場擴展奠定了堅實的基礎。我們成熟的交付能力、強勁的客戶留存率，以及於各個營運環節及夥伴合作領域的整合，為持續擴張奠定穩固基礎。於2023年、2024年及2025年，客戶留存率分別保持在63.5%、73.2%及82.8%。

我們的業務模式

我們主要提供MCU、SoC及ASIC產品，結合嵌入式算法和支持軟件，提供一站式智能控制解決方案。此外，我們還提供開發工具等相關產品，協助客戶將我們的解決方案無縫整合至最終產品，並加速產品上市時間。

我們遵循無晶圓廠模式營運，將資源聚焦於芯片設計、平台開發及市場主導創新，並與頂尖晶圓代工廠及半導體封裝測試服務供應商合作，將我們的設計轉化為高品質及可擴展的產品。

概 要

MCU、SoC及ASIC產品的比較

下表載列MCU、SoC及ASIC的架構、功能、產品定位及典型應用場景的比較概覽，以說明我們主要半導體產品的各自特點：

方面	MCU	SoC	ASIC
架構	<ul style="list-style-type: none">● 集成「一體化」芯片，結合CPU、內存及標準接口● 結構簡單，可在無外部元件的情況下運作	<ul style="list-style-type: none">● 高度集成芯片，將多個功能模塊整合於一個芯片中，實現更強大的多樣化功能	<ul style="list-style-type: none">● 為特定功能打造的完全客製化電路。僅包含目標用例所需的元件，不包含通用架構
功能	<ul style="list-style-type: none">● 執行基本的通用控制任務，如溫度傳感或電機控制；● 邏輯相對簡單，可以跨應用程序重用；● 不支持複雜的操作系統	<ul style="list-style-type: none">● 支持並行處理和多任務處理，通過多核設計實現；● 能處理更複雜的計算和處理任務	<ul style="list-style-type: none">● 專為單一用途而設計，具有最高的效率和性能；● 無法修改或擴大應用範圍
產品定位	<ul style="list-style-type: none">● 針對成本敏感和使用簡單的情景；● 以「低功耗、低成本、低複雜度」著稱	<ul style="list-style-type: none">● 針對需要更高集成度和功能性的性能敏感場景● 也用於多功能應用	<ul style="list-style-type: none">● 針對大容量、高性能應用；● 優先考量長期效益，而非前期開發成本
應用	<ul style="list-style-type: none">● 成本敏感用例，如家用電器、智能電錶和基本汽車模塊（如照明控制）	<ul style="list-style-type: none">● 需要更多處理能力或多種功能的產品，例如智能家電（如洗衣機、冰箱）、信息娛樂系統或AIoT設備	<ul style="list-style-type: none">● 具有非常特定需求的大容量高性能場景，例如LCD驅動器、生物識別傳感器或電池充電管理

儘管該等產品在架構、功能、技術目的及常見應用場景方面存在差異，但普遍採用相似的定價機制，並銷售予相近的分銷商及最終客戶群體。

MCU與ASIC之間的功能區別可以通過其應用範圍進一步說明。MCU的「單一控制任務」通常指簡單但廣泛需要的功能，例如溫度傳感或風扇速度控制，這些功能在許多應用中不可或缺，僅需微調軟件即可快速應用於不同系統中。相較之下，ASIC的「專用功能」則是針對單一場景高度定製，並通過固定的電路邏輯實現。此類功能不擬作重複使用或修改，而是優先考慮大規模重複部署中的性能、效率及一致性。

至於SoC，其支持多任務和並行處理的能力來自以下因素的組合：(i)多核或混合處理架構；(ii)具備專用硬件加速模塊，能夠獨立執行特定任務；及(iii)支持並行數據處理的強大內存和高速總線系統。即使SoC最終應用於單一商業功能，其固有的架構優勢仍能提供MCU無法提供的高效、可擴展性能。

概 要

我們的生產模式

我們主要採用無晶圓業務模式，據此，我們並未擁有或經營半導體製造或封裝設施。反之，我們主要委託信譽良好的晶圓代工廠進行晶圓製造，並由頂尖OSAT供應商提供IC封裝及測試(統稱為「生產合作夥伴」)。截至最後可行日，我們與六家晶圓代工夥伴及20家OSAT合作夥伴就IC封裝及測試保持緊密合作。於往績期間及直至最後可行日期，我們的生產合作夥伴並無對我們的生產能力施加任何重大限制。

在該模式下，一旦我們的內部研發團隊完成芯片的實體設計版圖，最終的設計圖將送交光罩製造商生產高精度光罩。隨後，供應鏈團隊與選定的代工合作夥伴協調芯片製造，同時提供光罩以推進生產。完成後，視乎合約安排，晶圓將交付予我們或我們指定的OSAT合作夥伴。OSAT合作夥伴將根據我們的技術規格進行封裝及測試。製成品隨後會返還我們作最終檢驗，並於獲得批准後儲存於我們的倉庫以供裝運。

為補充此無晶圓生產模式及支持快速產品迭代，我們已於四川省遂寧市建立一條自有生產線(「遂寧生產線」)，該生產線在我們的封裝及測試流程中發揮戰略性作用。遂寧生產線主要負責：

- 快速封裝及測試新開發的產品，加快產品上市時間；
- 執行需要更多定製處理的特定類型的封裝任務；及
- 對外包予不具備內部測試能力的封裝合作夥伴的芯片進行最終產品測試。

市場機遇

在全球數字化和自動化加速下，MCU作為嵌入式智能控制系統核心組件，將充分受惠於下游需求增加。根據弗若斯特沙利文資料，得益於智能及連網裝置應用日益普及，預計全球及中國MCU市場於未來數年將持續擴張。中國是最具活力的MCU應用市場，得力於消費電子、智能家電、工業控制、汽車電子，以及AI計算和機器人等新興領域的快速發展。詳情請參閱「行業概覽 — MCU產業概覽」。

憑藉逾二十年的行業經驗，我們已建立起廣闊的客戶基礎及涵蓋製造和OSAT領域的堅實合作夥伴網絡。依託我們的核心技術優勢，包括模塊化芯片設計及開發平台、可重複使用的IP庫和在前沿技術領域的戰略投資，我們具備有利條件，能夠把握全球機遇，加速拓展至高增長領域。

競爭優勢

我們相信以下競爭優勢可為我們達致可持續增長賦能：

- 中國領先的以MCU為核心的智能控制解決方案提供商；
- 豐富的研發資源和深厚的技術儲備構建了廣闊的技術護城河；
- 多元化產品矩陣和廣泛的產品應用領域；

概 要

- 深度客戶合作與廣闊客戶佈局；
- 穩定協同的供應鏈合作體系；及
- 遠見卓識且專業功底深厚的管理層引領持續成長。

業務戰略

倚託現有優勢，我們擬推行以下戰略，把握日益增長的市場機遇，進一步鞏固市場地位，達成企業使命：

- 繼續加大研發投入，深化多領域技術突破；
- 擴大產品組合，爭取高端應用市場並提升市場份額；
- 持續鞏固現有客戶合作，攻堅頭部客戶並拓展海外市場；
- 構建全球人才庫，強化研發人才儲備；及
- 加強並拓展中國境外業務；
- 選擇性進行策略收購。

我們的客戶及供應商

我們的客戶

往績期間內，我們的客戶主要包括分銷商及直銷客戶，且均位於中國。於2023年、2024年及2025年，我們五大客戶貢獻的收益於往績期間內各年度分別為人民幣172.2百萬元、人民幣225.0百萬元及人民幣277.7百萬元，分別佔我們同期的總收益24.1%、24.7%及24.8%。於2023年、2024年及2025年，我們最大客戶貢獻的收益於往績期間內各年度分別為人民幣85.5百萬元、人民幣105.0百萬元及人民幣115.6百萬元，分別佔我們同年的總收益12.0%、11.5%及10.3%。請參閱「業務 — 我們的客戶」以了解更多詳情。

據我們所知，於往績期間及截至最後可行日期，我們於往績期間內各年度的五大客戶均為獨立第三方。截至最後可行日期，概無董事、彼等的聯繫人或任何據董事所知悉持有我們的已發行股本超過5%的股東，於往績期間內各年度在我們的五大客戶中擁有任何權益。

我們的供應商

往績期間內，我們的供應商主要包括：(i)晶圓代工廠；(ii)提供封裝測試服務的OSAT供應商；及(iii)其他配件及設備供應商。於2023年、2024年及2025年，我們向五大供應商的採購金額，於往績期間內各年度分別為人民幣511.3百萬元、人民幣488.5百萬元及人民幣618.9百萬元，分別佔我們同期的總採購額90.1%、85.6%及86.5%。於2023年、2024年及2025年，我們向最大供應商作出的採購額，於往績期間內各年度分別為人民幣265.4百萬元、人民幣274.0百萬元及人民幣388.1百萬元，分別佔我們同期的總採購額46.8%、48.0%及54.3%。請參閱「業務 — 我們的供應商 — 我們的主要供應商」以了解更多詳情。

概 要

據我們所知，於往績期間及截至最後可行日期，我們於往績期間內各年度的五大供應商均為獨立第三方。截至最後可行日期，概無董事、彼等的聯繫人或任何據董事所知悉持有我們的已發行股本超過5%的股東，於往績期間內各年度在我們的五大供應商中擁有任何權益。

對供應商A的依賴

供應商A於往績期間內各年度一直為我們的最大供應商，為我們提供大部分由代工廠生產的晶圓。據弗若斯特沙利文所指，業內普遍情況下，IC設計公司會將大部分晶圓採購集中於少數可信賴的代工夥伴，以確保品質穩定及生產管理集中。董事認為我們與供應商A的合作關係出現重大不利變動或終止的風險很低。請參閱「業務 — 我們的供應商 — 對供應商A的依賴」以了解更多詳情。

競爭

全球IC設計行業的競爭十分激烈，而且准入壁壘很高，包括複雜的研發需求、漫長的開發週期以及供應鏈各環節的緊密協調。一方面全球龍頭企業主導了關鍵細分市場，但中國IC設計市場仍然較為分散，參與者需在產品效能、成本結構、上市時效及多種應用場景的服務能力等方面展開競爭。在此背景下，我們憑藉對產品可靠性、成本效益的專注及積極與客戶互動而突圍而出。

根據弗若斯特沙利文資料，以2024年出貨量計，我們在中國MCU市場排名第一，市場佔有率為12.6%，而於同年以收入計則排名第三。有關排名反映我們藉產品組合多元化、客戶黏性強及品牌知名度日益提升，能夠贏取設計訂單並擴大市場份額。

風險因素

我們的業務面對多項風險，包括「風險因素」一節所載者。由於不同[編纂]確定風險程度的詮釋方法和準則有別，閣下決定投資於[編纂]前，應閱讀「風險因素」章節全文。我們面臨的部分重大風險包括：

- 倘我們未能及時回應市場趨勢，或未能及時開發全新或經改良的解決方案及產品，我們的業務、經營業績及前景可能會受到重大不利影響。
- 我們的業務極度依賴下游行業的長期增長及技術進步，若有關領域的發展放緩，可能會對我們的經營業績及前景造成重大不利影響。
- 我們依賴第三方進行IC製造、測試及封裝。
- 我們經營所在市場競爭激烈，倘未能有效競爭，可能會對我們的業務、經營業績及增長前景造成重大不利影響。
- 我們依賴少數幾間供應商提供主要原材料，若供應出現嚴重中斷，可能會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成造成不利影響。
- 我們依賴單一主要晶圓供應商提供大部分主要原材料，若與該供應商的關係出現任何不利變化，可能會對我們的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。

概 要

我們的控股股東集團

於最後可行日期，根據一致行動協議，楊先生、周彥先生及周飛先生構成控股股東集團，而控股股東集團合共於223,292,700股本公司股份中擁有權益，佔本公司約55.77%的投票權。緊接[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，控股股東集團將有權行使約[編纂]%的本公司投票權。因此，就上市規則而言，控股股東集團將仍然為我們的控股股東集團。請參閱「與控股股東集團的關係」以了解更多詳情。

歷史財務資料概要

以下各表載列我們往績期間綜合財務資料的財務數據概要，乃摘自本文件附錄一所載會計師報告。

綜合損益及其他全面收益表節選項目

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
收益	713,570	911,655	1,122,150
銷售成本	(644,340)	(650,989)	(753,282)
毛利	69,230	260,666	368,868
除稅前(虧損)/溢利	(33,538)	137,632	305,030
所得稅抵免/(開支)	11,589	(798)	(20,848)
年度(虧損)/溢利	<u>(21,949)</u>	<u>136,834</u>	<u>284,182</u>
其他全面收益/(開支)			
可能重新分類至損益的項目：			
換算海外業務的匯兌差額	381	353	(447)
年度全面(開支)/收益總額	<u>(21,568)</u>	<u>137,187</u>	<u>283,735</u>

於往績期間，我們的財務表現經歷波動。於2023年，我們的毛利及毛利率顯著下降，主要源於行業整體衰退、下游需求疲軟，以及為加快售清存貨而實施策略性降價措施。該等因素亦導致2023年錄得淨虧損，與2024年及2025年分別錄得純利形成對比。於2024年，憑藉產品整合與設計效率提升降低單位生產成本，部分抵銷持續的定價壓力，毛利率得以回升。儘管盈利能力復甦，存貨撥備仍對整體毛利率表現產生抑制作用。於2025年，我們持續增長。詳情請參閱「財務資料 — 各年度的經營業績比較」。

概 要

收益

下表載列於所示期間按業務分部劃分的收益。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
解決方案及產品						
MCU解決方案	571,164	80.1	697,843	76.6	846,387	75.4
SoC解決方案	91,190	12.8	185,085	20.3	241,030	21.5
ASIC解決方案	32,280	4.5	24,048	2.6	31,489	2.8
其他相關產品 ⁽¹⁾	15,219	2.1	3,676	0.4	1,887	0.2
小計	709,853	99.5	910,652	99.9	1,120,793	99.9
其他產品 ⁽²⁾	1,223	0.2	1,003	0.1	1,357	0.1
其他服務 ⁽³⁾	2,494	0.3	—	—	—	—
總計	713,570	100.0	911,655	100.0	1,122,150	100.0

附註：

- (1) 其他相關產品主要包括功率器件及開發工具。
- (2) 其他產品主要包括銷售廢料。
- (3) 其他服務主要包括技術支持服務。

於往績期間我們的收益穩步增長，於2023年、2024年及2025年，我們分別錄得收益人民幣713.6百萬元、人民幣911.7百萬元、人民幣428.7百萬元及人民幣1,122.2百萬元。在此期間，我們的收益主要來自MCU、SoC及ASIC解決方案，波動主要受該等解決方案類別的銷量及產品組合變化影響，以應對下游市場需求及應用擴展，這通常抵銷了平均售價變化的影響。次之，我們亦從銷售其他相關產品獲得收益。請參閱「財務資料 — 綜合損益及其他全面收益表的主要項目描述 — 收益」以了解更多詳情。

下表列載於所示年度按產品類別劃分的銷量及平均售價。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	銷量	平均售價 ⁽¹⁾	銷量	平均售價 ⁽¹⁾	銷量	平均售價 ⁽¹⁾
	(千件)	(人民幣元)	(千件)	(人民幣元)	(千件)	(人民幣元)
MCU	1,417,561	0.40	1,908,191	0.37	3,374,022	0.25
SoCs	69,751	1.31	176,126	1.05	228,888	1.05
ASICs	295,369	0.11	310,968	0.08	420,214	0.07
其他相關產品 ⁽²⁾	31,707	0.48	3,433	1.07	37,870	0.05
總計	1,814,388		2,398,718		4,060,994	

附註：

- (1) 平均售價的計算方式為收益除以同期相應銷量。
- (2) 其他相關產品主要包括開發工具。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

概 要

下表載列我們於所示期間按應用場景劃分的提供解決方案及產品的收益明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣 千元	%	人民幣 千元	%	人民幣 千元	%
消費電子	310,706	43.8	359,457	39.5	466,682	41.6
智能家電	298,535	42.0	337,972	37.1	353,838	31.6
工業控制	78,156	11.0	184,905	20.3	246,829	22.0
汽車電子	22,456	3.2	28,318	3.1	53,444	4.8
總計	709,853	100.0	910,652	100.0	1,120,793	100.0

於往績期間內各年度，消費電子及智能家電合計佔我們來自提供解決方案及產品的收益的大部分，而工業控制及汽車電子領域的收益按絕對值則有所增加。於往績期間，不同應用領域的收益分佈整體上保持相對穩定。

下表載列我們於所示年度按銷售渠道劃分的提供解決方案及產品的收益明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣 千元	%	人民幣 千元	%	人民幣 千元	%
分銷	400,708	56.4	520,780	57.2	782,272	69.8
直銷	309,145	43.6	389,872	42.8	338,521	30.2
總計	709,853	100.0	910,652	100.0	1,120,793	100.0

於往績期間，我們來自提供解決方案及產品的收益中相當大部分是透過分銷渠道產生，各期間均持續佔總收益的絕大部分。直接銷售收益則佔其餘部分。

毛利及毛利率

下表列載於所示年度按業務列示：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	毛利 人民幣 千元	毛利率 %	毛利 人民幣 千元	毛利率 %	毛利 人民幣 千元	毛利率 %
解決方案及產品						
MCU解決方案	96,915	17.0	200,308	28.7	281,614	33.3
SoC解決方案	21,953	24.1	64,730	35.0	91,339	37.9
ASIC解決方案	2,098	6.5	5,573	23.2	8,828	28.0
其他相關產品 ⁽¹⁾	(12)	0.0	711	19.3	1,555	82.4
小計	120,954	17.0	271,322	29.8	383,336	34.2
其他						
其他產品 ⁽²⁾	1,044	85.4	940	93.7	1,357	100.0
其他服務 ⁽³⁾	2,494	100.0	—	—	—	—
小計	3,538	95.2	940	93.7	1,357	100.0
存貨減值撥備淨額	(55,262)		(11,596)		(15,825)	
總計	69,230	9.7	260,666	28.6	368,868	32.9

概 要

附註：

- (1) 其他相關產品主要包括開發工具。
- (2) 其他產品主要包括銷售廢料。
- (3) 其他服務主要包括技術支持服務。

於往績期間，我們的毛利及毛利率增長，主要因為產品定價策略及成本結構的變化，以及存貨撥備所致。2023年，主要產品類別的毛利及毛利率均相對較低，主要是由於因市場競爭加劇而策略性地減價及清倉、出售在晶圓價格上漲期間採購的高成本存貨及半導體市況偏軟所致。於2024年及2025年，隨著下游需求反彈，我們的盈利能力亦顯著提升，此乃受到推出具備性能強化與晶粒尺寸縮減的新產品帶動，可提升生產效率及有效降低單位成本。請參閱「財務資料 — 各年度的經營業績比較」以了解更多詳情。

下表載列我們於所示年度按應用場景劃分的提供解決方案及產品的毛利及毛利率：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	人民幣 千元	%	人民幣 千元	%	人民幣 千元	%
消費電子	13,581	4.4	63,671	17.7	129,197	27.7
智能家電	81,040	27.1	122,324	36.2	133,208	37.6
工業控制	17,604	22.5	70,610	38.2	96,438	39.1
汽車電子	8,729	38.9	14,717	52.0	24,493	45.8
小計	120,954	17.0	271,322	29.8	383,336	34.2
存貨減值撥備淨額	(55,262)		(11,596)		(15,825)	
總計	65,692	9.3	259,726	28.5	367,511	32.8

於往績期間，按應用場景劃分的提供解決方案及產品的毛利及毛利率逐步增長，主要反映客戶組合、定價策略及成本結構的變化。於2023年，各主要應用場景的毛利率均相對較低，尤其是在消費電子及智能家電領域，其因價格下調及清倉措施所致。於2024年，受惠於推出性能提升且晶粒尺寸縮減的新產品及原材料成本下降，下游需求反彈令利潤率回升。於2025年，我們提供解決方案及產品的整體毛利率進一步提升至32.8%，反映成本效益持續改善及產品組合優化。

(淨虧損)／純利

於往績期間，我們的淨業績由淨虧損轉為持續獲利，主要因收益、毛利、其他收入及收益以及營運開支的變動所致。於2023年，我們錄得淨虧損人民幣21.9百萬元，主要是由於毛利因價格壓力加劇、清倉、存貨減值及出售高成本存貨而大幅下滑，其影響抵銷了收益及其他收入的增長。於2024年，我們的純利錄得人民幣136.8百萬元，主要是受到產品表現改善及成本優化令毛利回升以及收益持續增長及其他收入的貢獻所帶動。於2025年，純利增加至人民幣284.2百萬元，主要是由於收益增長、毛利率進一步改善及有效的成本控制措施所致。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

概 要

綜合財務狀況表節選項目

下表載列於所示日期的綜合財務狀況表節選項目：

	於12月31日		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
非流動資產總額	249,808	230,326	301,986
流動資產總額	2,901,272	3,078,978	3,377,370
總資產	3,151,080	3,309,304	3,679,356
非流動負債總額	26,399	23,396	26,810
流動負債總額	153,042	292,538	475,156
總負債	179,441	315,934	501,966
資產淨值	2,971,639	2,993,370	3,177,390
流動資產淨值	2,748,230	2,786,440	2,902,214

於2023年、2024年及2025年12月31日的流動資產淨值維持相對穩定。請參閱「財務資料 — 綜合財務狀況表若干關鍵項目之討論」以了解更多詳情。

綜合現金流量表節選項目

下表載列於所示年度綜合現金流量表的節選項目：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
經營活動所得現金淨額	8,781	291,675	300,346
投資活動所得／(所用)現金淨額	50,977	(968,694)	(177,919)
融資活動所用現金淨額	(205,192)	(24,784)	(19,075)
現金及現金等價物(減少)／增加淨額	(145,434)	(701,803)	103,352
年初現金及現金等價物	1,062,308	917,255	215,805
換算海外業務現金流量產生的匯兌差額	381	353	(447)
年末現金及現金等價物	917,255	215,805	318,710

我們增加採購存貨以滿足預期需求及緩減供應鏈風險，延長選定客戶的信貸期以支持銷售增長，並預付款項以確保產能及原材料穩定。請參閱「財務資料 — 流動資金與資本資源 — 現金流量」以了解更多詳情。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

概 要

主要財務比率

下表載列我們於所示日期或年度的若干主要財務比率：

	於12月31日／截至該日止年度		
	2023年	2024年	2025年
毛利率	9.7%	28.6%	32.9%
流動比率	19.0x	10.5x	7.1x
速動比率	15.9x	9.2x	6.4x

有關計算上述比率的說明，請參閱「財務資料 — 主要財務比率」。

近期發展及並無重大不利變動

近期發展

於2025年12月31日後及直至2026年2月28日為止，我們的營運及財務持續錄得穩定增長。於該期間，我們持續從現有及新客戶取得新訂單。總銷量達約826.3百萬件，呈現持續增長勢頭。根據我們的管理賬目，我們於該期間的收益實現了超過35.0%的同比增長，並保持了超過36.0%的總毛利率。該增長主要是由於我們的汽車電子MCU解決方案的銷售增加，並得到持續的產品改進、解決方案擴展和深化客戶參與的支持。這些積極的發展加強了我們的盈利能力，並為我們的長期增長奠定了堅實的基礎。

並無重大不利變動

董事確認，直至本文件日期，我們的業務模式及經營所在的整體經濟及監管環境均未發生重大變動，自2025年12月31日（即本文件附錄一會計師報告所載本集團最新經審核綜合財務狀況表的日期）以來，我們的財務或經營狀況或前景亦無發生重大不利變動。

於上海證券交易所科創板上市

自2022年起，本公司於上海證券交易所科創板上市。於最後可行日期，董事確認我們並無在任何重大方面嚴重違反上海證券交易所科創板適用規則及中國其他適用證券法律法規，且據董事作出一切合理查詢後所知，並無與我們於上海證券交易所科創板的合規記錄有關的重大事項須提請[編纂]垂注。中國法律顧問認為，自A股上市起直至最後可行日期，並無任何嚴重違反上海證券交易所科創板適用規則及其他適用中國證券法律法規的情況。根據獨家保薦人進行的獨立盡職審查，獨家保薦人並未發現任何事項導致其不同意董事就本公司於上海證券交易所科創板的合規記錄所作的確認。

申請於聯交所[編纂]

我們已向聯交所[編纂]委員會申請批准根據[編纂]將予發行的H股[編纂]及[編纂]，該申請乃基於（其中包括）我們符合上市規則第8.05(3)條項下的市值／收益測試，其中參考：(i)我們截至2025年12月31日止財政年度的收益為人民幣1,122.2百萬元，超過500百萬港元；及(ii)我們[編纂]時的預期市

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

概 要

值，根據每股[編纂]的[編纂]為[編纂]港元(即本文件所載指示性[編纂]的中位數)計算，將超過40億港元。

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]估計[編纂]總額(基於[編纂]指示性[編纂]中位數，且假設[編纂]未獲行使)約為人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)，包括(i)所有[編纂]的[編纂]佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費約[編纂]百萬港元；及(ii)非[編纂]相關開支約[編纂]百萬港元，其中包括(a)法律顧問及申報會計師費用及開支約[編纂]百萬港元；及(b)保薦人費用及其他費用及開支約[編纂]百萬港元，佔[編纂][編纂]約[編纂]%(基於相同假設)。

於往績期間，我們產生[編纂]人民幣[編纂]百萬元，其中人民幣[編纂]百萬元已於綜合損益及其他全面收益表中確認為行政開支，而人民幣[編纂]百萬元將於[編纂]後自股本中扣除。我們預期將產生[編纂]約人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)列入行政開支，以及約人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)於[編纂]後直接列入股本削減。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

概 要

上述[編纂]為最新可行估計，僅供參考，實際金額可能與此估計有所出入。

股息及股息政策

我們於往績期間內各年度均有宣派及派付股息。我們於2023年、2024年及2025年分別派發股息人民幣180.2百萬元、人民幣99.9百萬元及人民幣99.7百萬元。於2023年及2024年宣派的股息已於最後可行日期結付。截至2025年12月31日止年度，向現有股東派發的建議股息約人民幣119.7百萬元已獲董事會批准，並須待股東於目前定於2026年4月9日舉行的股東週年大會上批准。待有關批准後，本公司預期於[編纂]前以其內部現金資源支付股息。

我們無法保證任何特定年度將宣告或派發股息。請參閱「財務資料 — 股息及股息政策」。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]的中位數)，經扣除[編纂]費用及佣金以及我們估計就[編纂]應付的開支後且假設[編纂]並無獲行使，我們估計將收取的[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元。

依循我們的業務戰略，我們擬將[編纂][編纂]用於下列用途：

[編纂] 百分比	約百萬港元	未來計劃
[編纂]%	[編纂]	提升我們的研發能力並加強技術開發平台
[編纂]%	[編纂]	策略性投資及收購
[編纂]%	[編纂]	在香港設立我們的全球營運及研發中心
[編纂]%	[編纂]	營運資金及一般企業用途

請參閱「未來計劃及[編纂]」以了解更多詳情。

上市規則規定的披露

董事確認，截至最後可行日期，並無任何情況會導致股份於聯交所[編纂]時須根據上市規則第13章第13.13至13.19條規定作出披露。